



Patiently Satisfy Partner

AXI-9900線上X-ray自動檢測方案



1. 設備外觀



2. 設備技術參數



	Model	AXI-9900
光管	光管類型	封閉式
	空間解析度	5 μ m
	光管電壓	130kv
	光管電流	300 μ A
平板	取像方式	平板數字成像 (進口)
	成像精度	85 μ m
	A/D轉換量化密度值	16bit (65536)
	解析度	1536*1536px
	採集幀頻	20 (FPS)
系統	放大倍率	150x
	總放大倍率	高達1000 x高清配置
	攝像機	0505j
	XYZ工作臺	5 μ m解析度
	定位輔助	鐳射十字準線, 圖像視覺定位
	Xsoft軟體	高級影像處理軟體, 包括基於視圖的檢查程式設計
	Xsoft軟體	用於半自動檢測的功能和CNC檢測宏程式設計
	影像處理軟體	全面的X射線檢測軟體, 包括圖像增強功能、測量
	vc module (包含在基本包中)	自動計算套裝軟體, 包括多個晶片貼裝空洞評估的能力, 不規則形狀的區域焊接也可以手動檢查
	bga test module	直觀的自動BGA焊點評估
	作業系統	WINDOWS 10
	電源/功率	AC110-220V50-60HZ 1800W
	輻射安全測試	<1 uSV/H

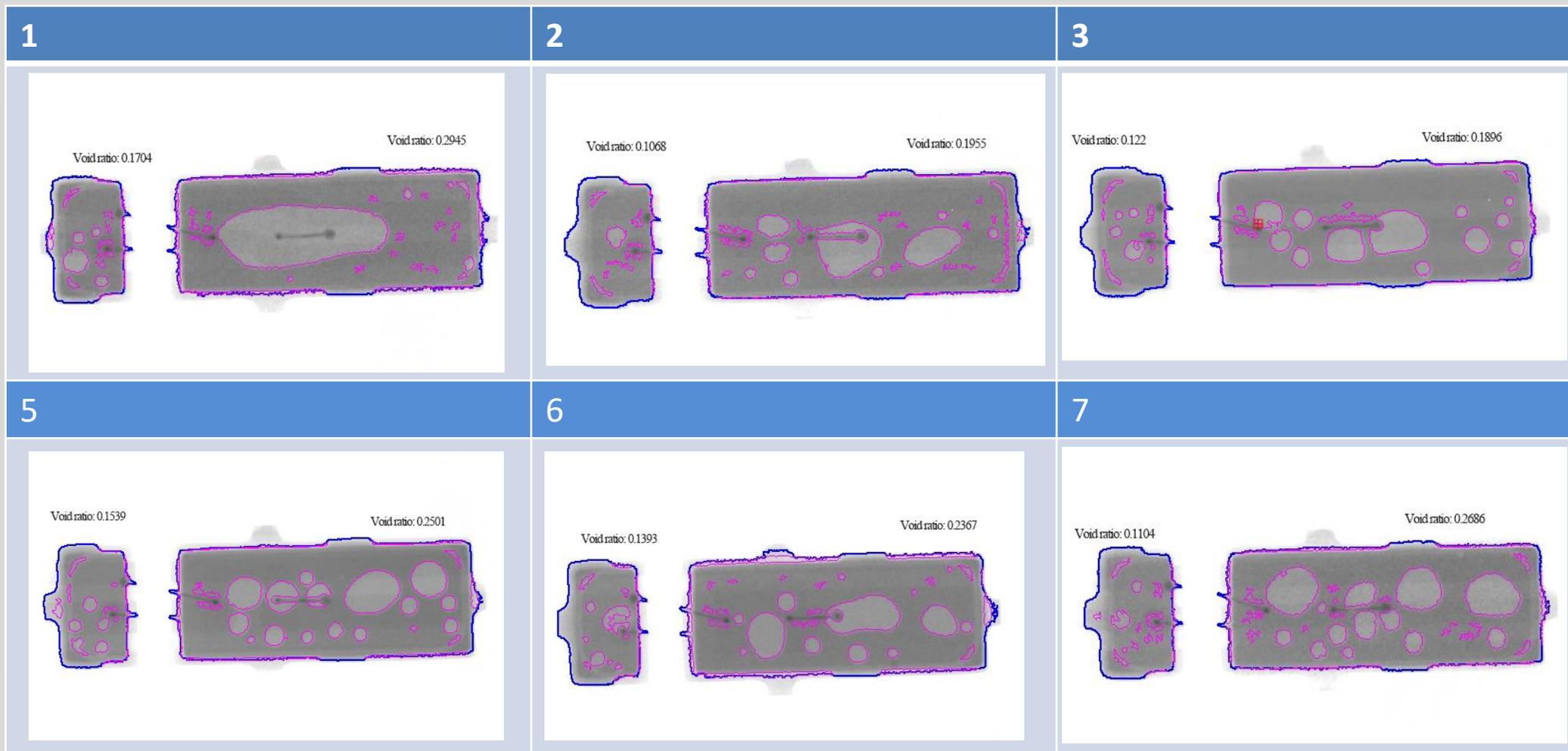
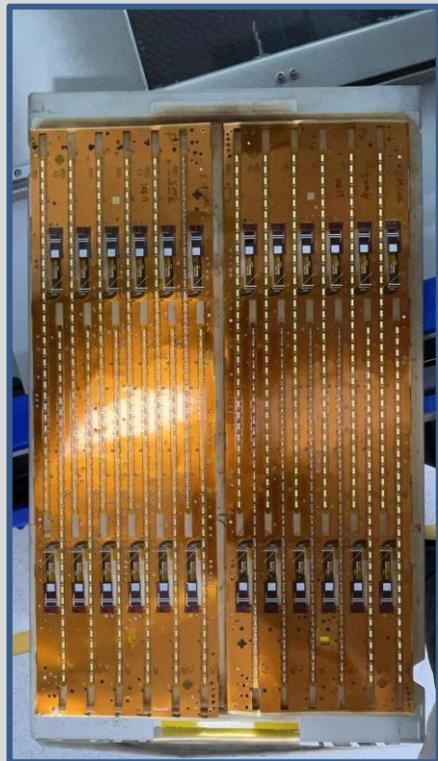
2. 設備技術參數



	Model	AXI-9900
結構	運動精度	高精度無振動同步數控操作
	機械操作	8軸
	斜視圖旋轉	(360°旋轉為選項)
	操作輔助	自動等心機械手運動, 主動防撞系統
	軸速	(X-Y-Z) 10微米/秒至120毫米/秒
	可調節的板寬	自動調節
	載物台尺寸	510*750mm
	檢測範圍	510*640mm
	載物台承重	≤12kg
	機器尺寸	1640*1692*2186mm(L*W*H)
	機器重量	2850kg
平臺運動方式	CNC(自動模式)	
工藝設備能力	單板厚度	3mm
	單板翹曲	±2mm
	器件高度	小於150mm
	檢測元件	BGA/CSP、插入元件、SOP/QFP、電晶體、R/C晶片、底部電極元件、QFN、電源模組、POP、press-fit連接器等
	檢測項目	氣泡、開焊、無浸潤、焊錫量、偏移、橋接、爬錫、通孔焊錫填充、錫珠等
	檢測能力	Chip: 0201及以上; LSI: 0.3mm 間距及以上
	誤判率	0.5%
軟體要求	軟體易用性	軟體介面簡便, 可程式設計, 新員工只需簡單的培訓即可掌握操作
	報警功能	超出設定的規格限或公差值, 輸出異常點報警
	介面	標準上下位介面 (SMIMA)

3. 測試結果-氣泡檢測

測試樣品：



4. 測試結果說明

1. 採用AXI-9900全自動檢測設備針對檢測需求對樣品進行檢測，滿足自動氣泡，粘錫的要求。（樣品暫未檢測出粘錫）
2. 使用AI演算法，自動檢測產品氣泡，自動框選異物，精准定位。
3. 節拍要求：280秒檢測114個位點。

客戶名單 (部份) :



謝謝觀看！

靈祈科技有限公司

PSP Asia Co., Ltd.

連絡電話: +886-3-3115408

岳翔 Mark +886-986-308101

E-mail: mark@pspasia.com.tw

桃園市蘆竹區南崁路一段83號10F-5



靈祈科技官方LINE



PSP官方網站



FB粉絲團